

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	泰康资产、东财证券、中国人寿养老保险、信达澳亚基金、上海睿源基金、宝盈基金、招商信诺资管、中国建设银行、上海呈瑞投资、重庆渝汇投资、海南鑫焱投资、深圳圣为投资、中银理财、富国基金、富安达基金、平安证券、海通证券、上海世真投资、西安江岳基金、恒生前海基金、深圳茂源财富、Willing Capital、安邦资产、深圳鲲鹏恒隆投资、上海途灵资管、上海大威德投资、湖南八零后资管、中国银河证券、银华基金、华夏基金、太平洋保险资管、诺安基金、申万菱信基金、百年保险资管、华泰证券、东北证券、招商证券、开源证券、兴业证券、天风证券、山西证券	
时间	2026年2月26日-2026年3月6日	
地点	券商策略会、公司和线上	
上市公司接待人员姓名	总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 合规总监：李瑞媛 证券事务代表：徐雯	

投资者关系活动主要内容介绍

一、 公司介绍 2025 年度经营情况

根据公司披露的 2025 年度业绩快报公告，公司 2025 年营收 5.94 亿元，同比增长 37.54%；归母净利润 5,046 万元，同比增长 50.74%；扣非净利润同比增长 88.93%。利润增速较快主要系报告期内收入增长的同时，公司产品结构优化，毛利率持续提升，包括 2025 年先进封装光刻胶持续放量，晶圆制造先进节点电镀、清洗产品稳定量产等。

2026 年聚焦的业务重点：1、光刻胶产品持续突破和放量。华东制造基地一期主要扩充光刻胶和配套树脂的产能、预计 2028 年产能释放。在这之前，公司着重现有产线产能提升和中试线的建设，确保公司光刻胶业务持续增长。2、先进制程电镀产品的稳定量产。大马士革电镀铜添加剂以及超纯硫酸钴，这两款核心产品 2025 年均已在主流晶圆厂量产，2026 年稳步放量并推广至存储及其他晶圆厂。3、先进封装领域，在 HBM、HBF、TSV、TGV 等 2.5D、3D 最新的封装形式上，公司都是主流客户核心供应商，光刻胶、电镀液产品有机会成为 Baseline 供应商。

二、 问答交流环节

问题一：国际局势对公司原材料端的影响？

答：2026 年原材料成本可能有所上升，但对公司的影响较小，一是化工金属占比可控，不构成重大风险；二是公司供应链体系高度本地化，95% 以上来自国内，当前供应稳定，公司也积极与客户及供应商保持充分沟通，保障原材料供应稳定。

问题二：公司晶圆制造领域业务进展情况？

答：2025 年，公司晶圆制造材料业务实现从零到一的突破，收入主要来源于先进制程电镀液、清洗类产品以及 PSPI 与 I 线光刻胶。公司正积极拓展主流晶圆制造厂及存储芯片厂商，力争将其发展为公司核心客户群。战略布局上，先进封装与晶圆制造材料将作为双轮驱动，共同构成公司未来发展的重点领域。

问题三：公司晶圆制造业务未来的增量来自哪里？

答：公司晶圆制造业务的增量空间将主要源于以下三方面：一是先进制程电镀液与高端光刻胶产品的技术突破与批量导入；二是半导体行业景

	<p>气度回升，带动晶圆厂与存储厂需求增长；三是广阔的国产替代机遇与全球化布局的持续深化。</p> <p>问题四：研发费用率预期？</p> <p>答：公司作为研发驱动型企业，将持续加大研发投入以适应市场和客户需求的动态变化。未来研发费用率可能随营业收入的增长出现小幅增长，研发费用的绝对值将保持稳健增长。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2026年3月9日